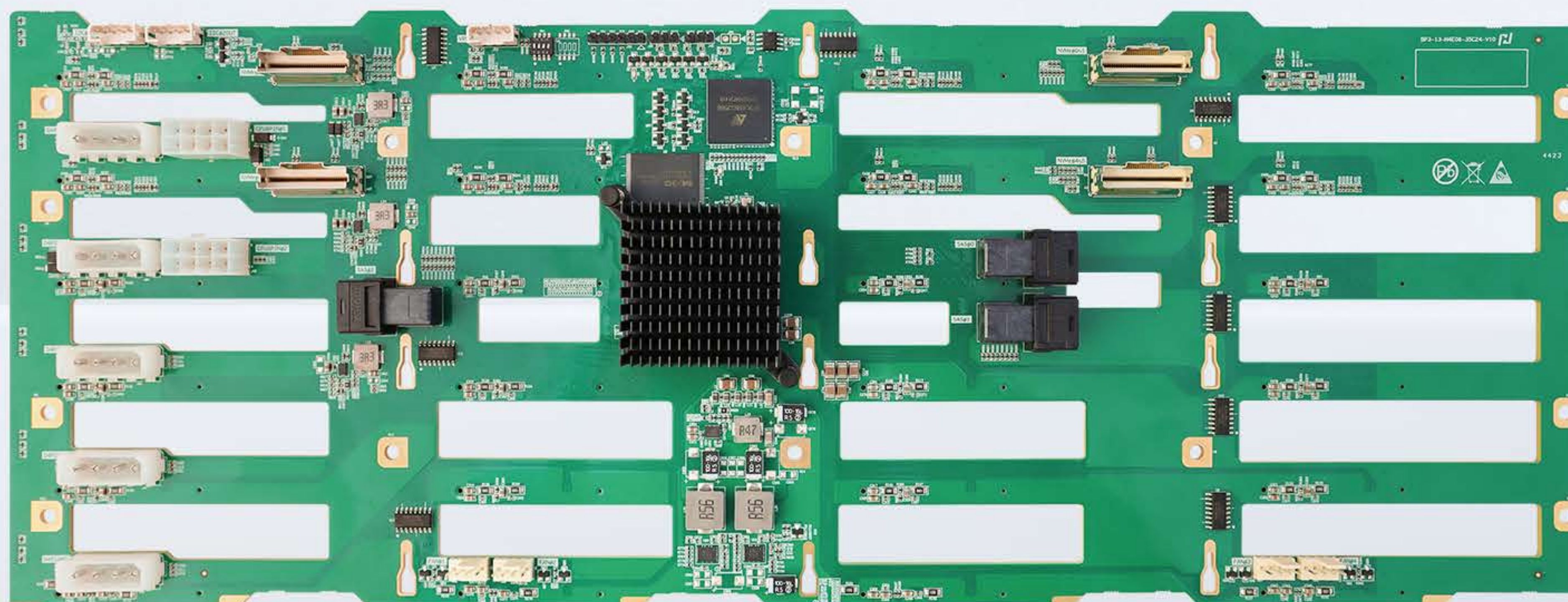


BP3-13-N4E08-35C24

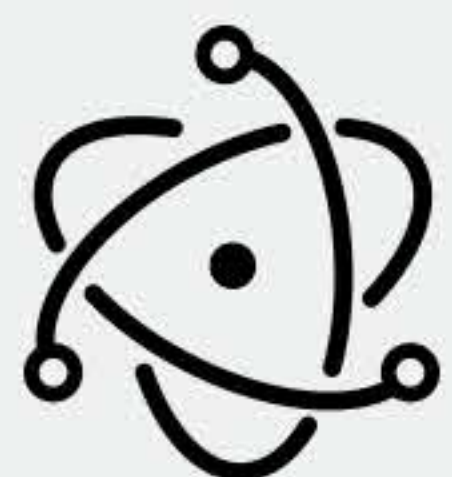
NVMe 混合扩展硬盘背板



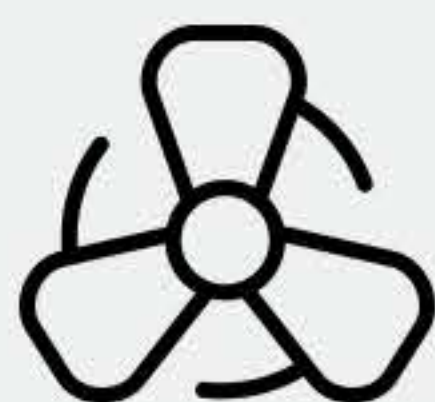
产品概述

- 4U24盘位 NVMe混合扩展硬盘背板
- 支持3.5" / 2.5" NVMe/SAS/SATA硬盘，标准SFF规范设计开发
- 支持SGPIO和I²C管理信号接口，可以满足NVMe/SAS/SATA硬盘LED管理和BMC通讯
- 支持国产化&非国产化全平台，风扇自动调速，固件在线升级，适配主流硬盘、线缆、板卡，布局和散热超行业标准优化
- 适合主流混闪和通用服务器，分布式系统，大数据，云服务等场景
- 覆盖互联网、电信、金融、政府、交通、院校等行业

产品特性



全平台兼容



风扇自动调速



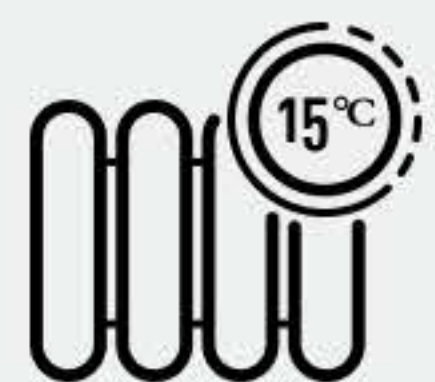
固件在线升级



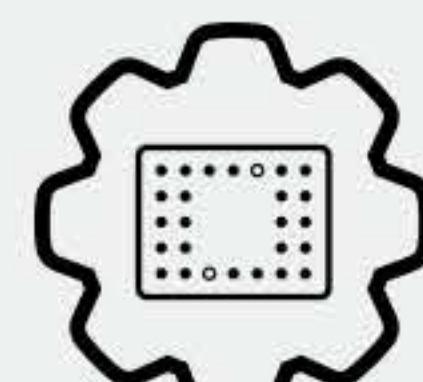
BMC兼容适配



主流兼容列表



系统散热优化



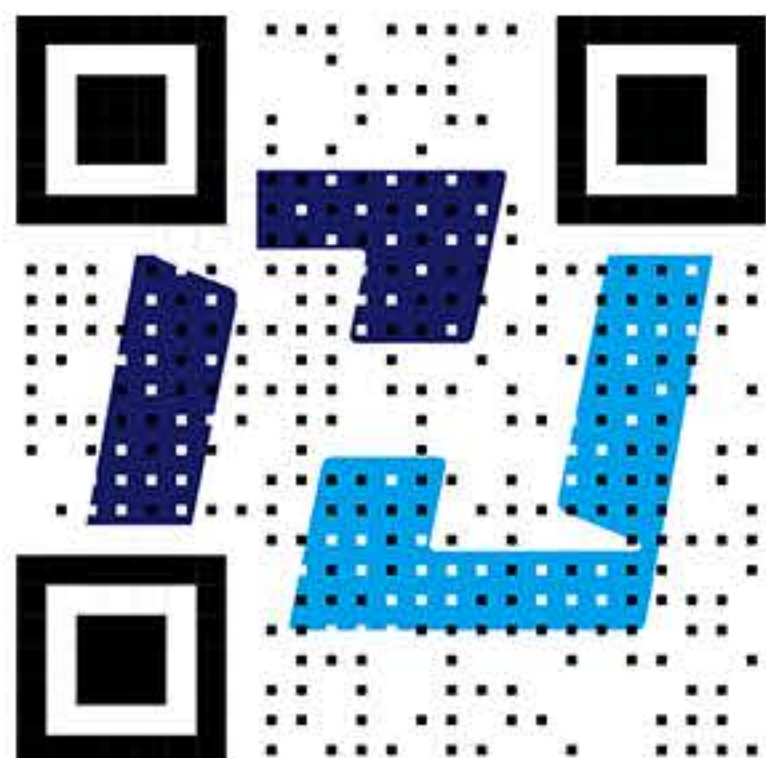
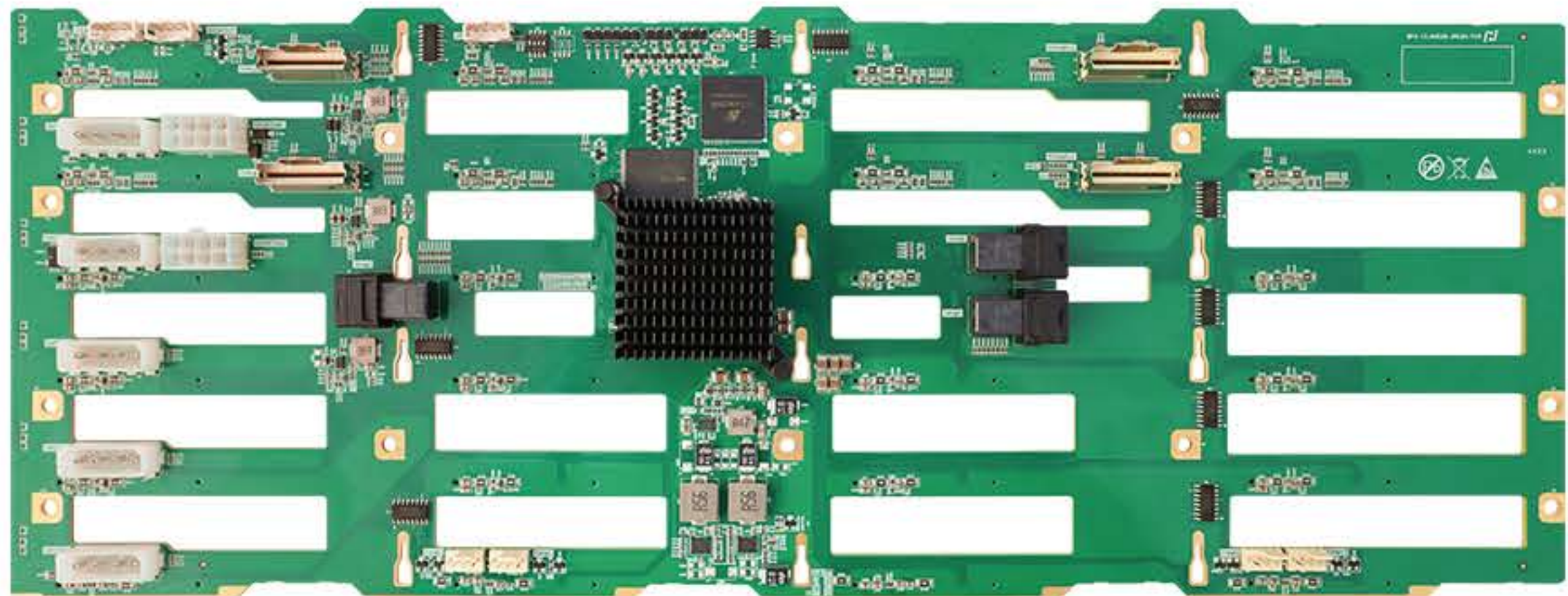
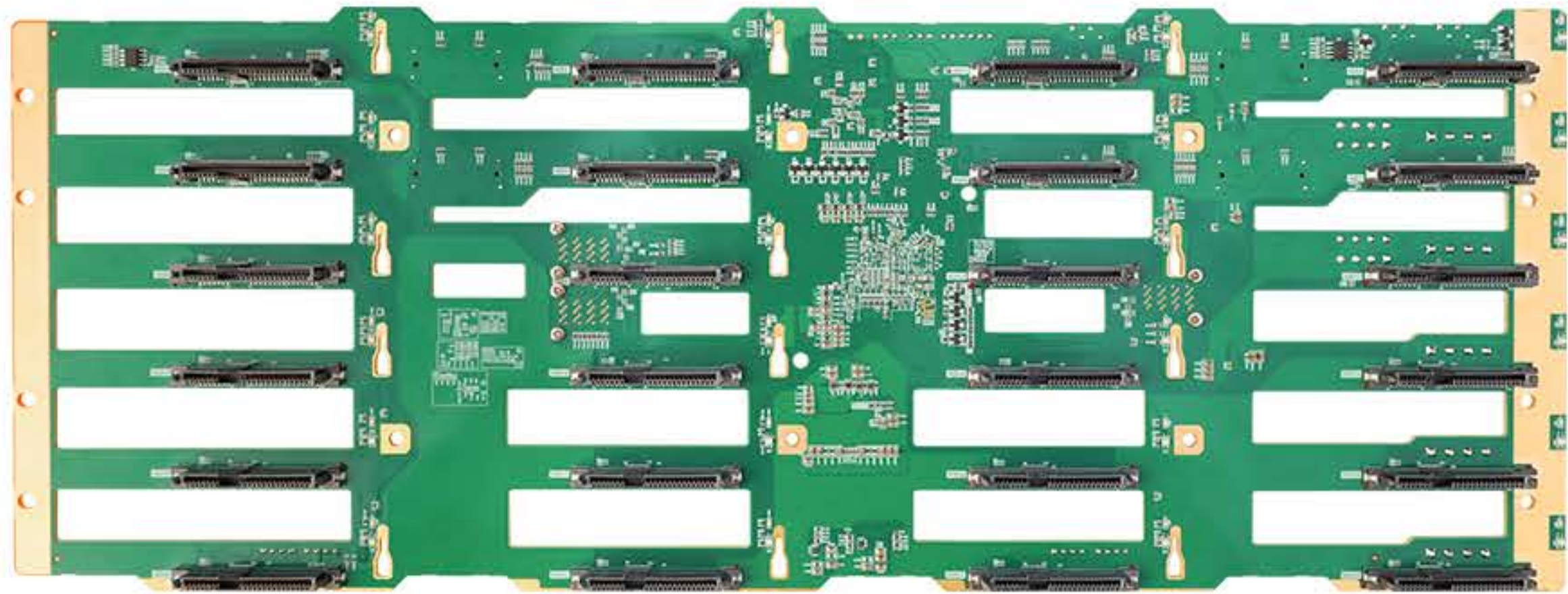
系统布局优化



BOM优化管理

技术规格

组件	描述
类型	NVMe硬盘背板
系列	NVMe混合扩展硬盘背板
规格	3.5" / 2.5" 4U24
盘位	24盘位
速率	PCIe 4.0 16GT/s & SAS 3.0 12Gb/s
硬盘接口	SFF-8639 *8 & SFF-8482 *16
上行接口（PCIe）	Slimline SFF-8654 x8 *4（遵循SFF-9402 R1.1规范）
上行接口（SAS）	MiniSAS HD SFF-8643 x4 *3（遵循SFF-9402 R1.1规范）
电源接口	CPU8PIN *2 / D4PIN *5
风扇接口	FAN4PIN风扇 *4（支持监控）
管理信号	- 支持SGPIO（SAS/SATA硬盘LED） - 支持I²C *2（BMC通讯、硬盘管理、在线升级、风扇控制）
硬盘LED	- Activity 蓝灯（13客户定制规范） - Status 红绿双色灯（13客户定制规范）
扩展芯片	Broadcom 35x系列
通风孔面积	26.00%
重量	467.0g
产品特性	- 全平台兼容 - 主流兼容列表 - 风扇自动调速 - 系统散热优化 - 固件在线升级 - 系统布局优化 - BMC兼容适配 - BOM优化管理
产品编号	20220240011



华科微（北京）科技有限公司

地 址：北京市海淀区唐家岭路百旺弘祥科技文化创意园3号楼2层3228
网 址：www.huakewei.com.cn
固定电话：010-82825150 手 机：18500365505

免责声明：本彩页中所提到的信息，如因产品升级或其它原因导致信息变更，恕不另行通知；本彩页中所涉及的产品图片均以产品实物为准。